

# 广东富信科技股份有限公司

## 投资者关系活动记录表

股票简称：富信科技 证券代码：688662 记录表编号：2021-010

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他： <u>  视频电话会议  </u>
参与单位名称及人员 姓名	1、华夏基金管理有限公司：张景松、郭琨研 2、兴业证券经济与金融研究院：章林
时间	2021年7月7日 21:00-22:00
地点	视频电话会议
公司接待人员姓名	董事会秘书兼财务总监：刘春光 证券事务代表助理：霍莹敏
投资者关系活动 主要内容介绍	<p>一、董事会秘书兼财务总监刘春光通过 PPT 介绍公司基本情况</p> <p>二、机构与高管问答交流</p> <p>问 1：请问 GR-468-CORE、MIL-STD-883 标准是什么性质的标准？对于用于光模块的微型器件是否均需要符合 GR-468-CORE、MIL-STD-883 标准，公司产品是否已通过这两项标准？</p> <p>答：GR-468-CORE 标准是国际通用可靠性试验标准及用于通信设备的光电子器件通用可靠性保证要求；MIL-STD-883 是微电子器件试验方法标准，即美国国防部可靠性测试标准，主要讲述和规定军用微电子器件、元件、微电路的各种可靠性试验方法和程序。</p> <p>对于用于光模块的微型器件均需要符合 GR-468-CORE、MIL-STD-883 二项标准。公司的微型热电器件的可靠性指标均已满足二项标准规定的要求。</p>

	<p>问 2：请问公司的半导体材料制备的工艺流程如何？</p> <p>答：公司目前所用的半导体材料是碲化铋合金半导体材料，我们通过外购单质原材料，按照一定的配比，再通过一系列复杂的制备工艺制成最终的半导体材料。</p> <p>影响半导体热电材料性能水平的因素主要有两方面：一是半导体材料本身的成分构成，我们称之为“配方”；二是在“配方”的基础上的制备工艺。</p> <p>公司是目前行业内为数不多的同时掌握碲化铋基半导体材料区熔、热压、热挤压三种制备技术的企业：</p> <p>（1）区熔技术的特点是工艺简单，成本低，其制成的材料性能不错但机械强度低，主要应用于消费电子产品领域；</p> <p>（2）热压技术在提升材料热电性能的同时，解决了机械强度的问题，但仅适用于 P 型碲化铋基材料，不适用 N 型材料，主要应用于消费电子产品；</p> <p>（3）热挤压技术制备的碲化铋基半导体材料同时具有良好的热电性能和机械强度，并能同时制备 P 型和 N 型材料，但工艺复杂，技术门槛高，生产成本相对较高，主要应用于 5G 通信光模块上的微型器件。</p> <p>其中，区熔技术是比较传统的制备技术，行业内大多数企业都相差不大；而热压技术，特别是热挤压技术作为相对先进的热电材料制备技术，只被少数企业所掌握。</p> <p>问 3：请问公司下游整机应用产品目前的销售结构分布情况？</p> <p>答：目前公司整机应用产品主要应用于消费电子领域，通讯及其他领域占比较少。</p>
附件清单（如有）	无